

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股



鹏鼎控股（深圳）股份有限公司  
2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金  
使用可行性分析报告

二〇二六年七月

公司为满足业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，拟向特定对象发行股票募集资金用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。公司对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下：

## 一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 960,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目	1,273,001.16	960,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

## 二、本次募集资金投资项目情况、必要性和可行性分析

### （一）项目情况

本次募集资金投资项目为庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，其具体情况如下：

#### （1）项目基本情况

本项目依托公司现有产业园厂房并拟新建厂房及配套公用设施，引进成型设备、镀铜设备、钻孔设备、压合设备、自动化设备、防焊设备、品保设备等先进生产设备，并配置高素质的生产、技术、管理等人员，打造面向 AI 服务器和高速光模块的高端 PCB 智能化生产基地。

#### （2）项目投资概算

本项目计划总投资 1,273,001.16 万元，主要投资包括建筑工程费、生产设备购置费等。本项目拟使用募集资金投入 960,000.00 万元。

#### （3）项目实施主体和实施地点

---

本项目的实施主体为公司全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司，实施地点为江苏省淮安市淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号。

#### （4）项目经济效益评价

本项目具备较好的经济效益。

#### （5）项目审批及备案情况

截至本报告公告日，本项目已取得江苏省投资项目备案证（备案号为淮管发改审备〔2026〕182 号），环评、能评等相关程序正在办理中。

### （二）项目实施的必要性

#### 1、提升公司高端 PCB 产能，匹配 AI 算力产业爆发式市场需求

AI 算力硬件是智能经济与算电协同的底层支撑，AI 服务器、交换机等配套算力基础设施对 PCB 的性能、材料、工艺提出了更高要求。作为 AI 算力基建的核心硬件，AI 服务器通常需要搭载多颗高性能 GPU 或 CPU，这对 PCB 的层数、材料以及制造工艺提出了严苛要求；高速光模块则承载着算力集群间海量数据的低延迟传输，对 PCB 的高频材料与精密制程亦提出严苛标准。

随着人工智能技术的快速发展及算力需求的持续提升，AI 服务器与高速光模块的迭代升级成为推动高阶 HDI 需求增长的核心动力。根据 Prismark 数据，2025 年 HDI 产值达 157.69 亿美元，同比增速高达 26.0%，为所有细分品类中最高；2025 年至 2030 年，全球 HDI 的市场规模将进一步增长至 2030 年的 244.90 亿美元，其中全球服务器及数据存储领域和有线通信领域的年复合增速分别为 25.7%、15.5%。

为顺应下游爆发式增长的市场需求，抢抓 AI 产业发展机遇，公司亟须突破高端 PCB 产能瓶颈，开展高端产能升级与扩张。本项目建设是公司完善高端 PCB 产能布局的关键举措，有利于巩固并提升公司在 AI 服务器、高速光模块 PCB 领域的市场占有率，夯实长期发展基础。

#### 2、深度布局 AI 算力配套赛道，巩固并提升公司行业龙头地位

全球人工智能产业正处于高速渗透、算力需求持续扩容的关键阶段，AI 服

---

务器、高速光模块是算力网络建设的核心硬件载体。相较于传统 PCB 产品，AI 服务器及高速光模块配套 PCB 技术壁垒高、下游认证严苛、产品附加值高；同时 AI 算力供应链高度集中，头部客户对 PCB 供应商的技术实力、交付能力、合规资质要求严苛，行业准入壁垒持续抬升，行业集中度不断提升。

当前 PCB 行业头部企业均大规模加码 AI 配套 PCB 赛道，行业竞争全面聚焦高端算力 PCB 领域。公司早在 2017 年便开始布局细线路高阶 HDI、SLP 等产品，在高阶 HDI 产品的研发制造方面具备深厚技术积淀，拥有优质通信及算力硬件客户资源。为扩大先发竞争优势，公司亟须针对性布局 AI 服务器、光模块配套 PCB 产能，深度挖掘下游算力硬件客户核心需求，巩固公司在高端 PCB 领域的龙头地位，助力实现长期战略发展目标。

### **3、建设高规格智能化产线，顺应 PCB 高频高速化技术升级趋势**

随着 AI 算力、高速通信等下游行业技术迭代持续加快，终端硬件产品向高速化、小型化、高密度化方向升级，推动配套印制电路板向高频高速、高密度化发展。AI 服务器及高速光模块用 PCB 产品加工工艺严苛、生产难度大、技术壁垒高，不仅需要高精度生产设备、智能化制造管控体系，更需要长期的技术积累与工艺沉淀；同时高端算力 PCB 下游客户认证周期长、验证标准严格，产业化落地门槛较高。

在此背景下，为顺应行业技术升级趋势，满足高速增长的高端算力 PCB 市场需求，紧抓产品结构高端化升级机遇，公司通过本次募投项目建设高规格智能化生产车间，投入先进生产及配套设备，强化高端产品供应能力，优化产品结构，持续推进 AI 算力配套高端 PCB 的战略布局，增强公司核心技术竞争力与长期盈利水平。

#### **（三）项目实施的可行性**

##### **1、国家产业政策大力支持 PCB 行业发展，为项目的实施提供了良好的政策环境**

印制电路板行业是电子信息制造业的核心基础组件，承担着电子元器件电气连接与信号传输的关键功能，其技术水平和产业规模直接关系到整个电子信息产

---

业链的安全与竞争力。近年来，我国政府对 PCB 行业发展高度重视，出台了一系列国家级战略规划与产业扶持政策，为行业高质量发展提供了系统性制度保障。

2023 年至 2025 年间，《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》等文件，不仅将高密度互连积层板明确纳入鼓励类产业，还对行业在产业布局、生产规模、工艺技术、智能制造、绿色制造及资源环境保护等方面提出了引导性要求，推动企业提升研发投入与人均产值，加快自动化、数字化与绿色化转型升级。同时，《战略性新兴产业分类（2018）》《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》等文件将高端印制电路板列为战略性新兴产业和数字经济核心产业，进一步凸显了 PCB 行业在国家经济结构调整和数字经济中的战略地位。

综上所述，国家对 PCB 行业高质量发展的政策扶持与推动，为项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

## **2、全球 PCB 市场规模稳步扩大，未来发展空间广阔**

PCB 主要承担电子元器件间的电路导通与信号传输功能，是电子设备的关键基础组件，被誉为“电子产品之母”。在 AI 算力系统的发展过程中，PCB 更是逐渐成为“神经中枢”，行业在 AI 的强力驱动下实现了快速增长。根据 PrismaMark 数据，2025 年全球 PCB 产值达 851.52 亿美元，同比增长 15.8%，这是全球 PCB 产值自 2021 年以来再度实现两位数增长。在智能化、低碳化等因素的驱动下，人工智能、新能源汽车、5G/6G 通信、物联网及智能终端等 PCB 下游应用行业预期将蓬勃发展，将带动 PCB 市场规模持续扩容。PrismaMark 预测，2030 年全球 PCB 产值将达到 1,233.48 亿美元，增量空间巨大。

中国 PCB 行业经历了从“跟跑”到“并跑”的演进过程，实现了从边缘参与者到全球最大生产基地的历史性跨越。根据 PrismaMark 数据，2025 年中国大陆 PCB 产值达 489.69 亿美元，在全球市场的份额进一步提升，达到 57.5%，连续二十年位居全球第一。根据 PrismaMark 预测，未来五年中国大陆 PCB 行业仍将保持高速增长，2030 年中国大陆 PCB 产值将达到 685.35 亿美元，2025 年至 2030 年复合年均增长率为 7.0%，市场前景广阔。

---

### **3、公司在相关领域具备深厚的技术积累和丰富的研发生产经验，为项目提供了技术保障**

公司深耕高端印制电路板领域二十余年，早在行业发展初期便深耕 HDI、SLP 等高精密 PCB 技术，技术优势与 AI 服务器对 PCB 的高阶化、高精密化需求高度契合，具备突出的技术先发优势。

近年来，公司持续加码高频高速算力 PCB 方向研发投入，高效实现技术成果向产品竞争力转化，已完成多款适配 AI 服务器、高速光模块的高阶 PCB 产品的技术开发。目前，公司已具备量产 6 阶以上 HDI 产品的能力，高阶 HDI 及 SLP 产品技术实力与量产能力行业领先。在 AI 服务器领域，公司已开发支持 GPU 模块的高阶 HDI、内埋元件等创新技术；在高速光模块领域，公司已实现 800G/1.6T 产品量产出货，3.2T 产品已进入研发阶段。

同时，公司针对 AI 算力产品需求，布局高速信号完整性、高频材料加工、高密度散热等前沿技术研发，持续攻克高端算力 PCB 生产关键工艺难题。依托完善的产学研协同机制，公司与多所知名大学及研究院深度合作，有效解决 AI 算力 PCB 在高速传输、散热管控、精密集成等方面的技术难点。

### **4、优质的客户资源为项目实施提供良好市场条件**

公司是全球少数可全面开展 PCB 产品设计、研发、制造及销售一体化服务的大型专业厂商。凭借先进的核心技术、稳定可靠的高端产品与专业高效的配套服务，公司在算力领域和端侧应用产品领域已与全球知名的终端厂商和 ODM 厂商建立长期稳定的合作关系。

在 AI 服务器领域，公司高阶 HDI 产品成功打入 AI 服务器市场并通过云服务厂商认证；在高速光模块领域，公司 SLP 产品已切入 800G/1.6T 高端市场并已实现量产出货，并与客户合作开发下一代 3.2T 光通讯解决方案。相关产品的突破与客户认证，充分印证了公司在高端 PCB 领域的技术实力与市场认可度。此外，依托全球化客户布局优势，公司建立全球多基地运营模式，可充分覆盖全球 AI 算力硬件市场需求。

优质且丰富的客户资源，不仅为项目投产后提供稳定的订单来源，同时持续

---

赋能公司前沿技术迭代与产品升级，为本项目实施提供充分的市场可行性。

### **三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响**

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目顺应下游应用领域发展趋势，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行将进一步扩大公司产能，加强公司在 AI 服务器与高速光模块等领域的布局，巩固公司在 PCB 行业的龙头地位，提升公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产规模将有所增长。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，公司的资金实力将显著增强，核心竞争力将全面提高，有利于增强公司未来的持续盈利能力。

### **四、可行性分析结论**

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的建设符合国家产业发展规划政策和产业发展的需求，契合公司的战略发展目标，具有良好的经济效益。公司在技术、人力、客户、管理等资源上有充分保障，通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会

2026年7月4日